证券代码：688403　证券简称：汇成股份　公告编号：2025-009
转债代码：118049　转债简称：汇成转债

# 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”）董事会编制了2024年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11,487,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金1,148,700,000.00元，坐扣承销和保荐费用3,500,000.00元（不含税）后的募集资金为1,145,200,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,672,108.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,142,527,891.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕336号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 114,252.79 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| | 利息收入净额 | B2 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 105,958.26 |
| | 利息收入净额 | C2 | 68.86 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 105,958.26 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 68.86 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 8,363.39 |
| 实际结余募集资金[注] | | F | 8,363.39 |
| 差异 | | G=E-F | |

注：其中公司募集资金专户存放的活期存款余额3,363.39万元，理财余额（含结构性存款）5,000.00万元，本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司扬州分行营业部 | 955080246966300186 | 22,127,085.26 | |
| 中信银行股份有限公司合肥瑞海支行 | 8112301013201026778 | 11,506,820.48 | |
| 招商银行股份有限公司合肥分行营业部 | 514902669010002 | | 已销户 |
| 浙商银行股份有限公司合肥分行营业部 | 3610000001012010588108 | | 已销户 |
| 兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 499030100100460563 | | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司扬州邗江支行 | 520980997944 | | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司扬州邗江支行 | 514902342810000 | | 已销户 |
| 合计 | | 33,633,905.74 | |

注：公司存放于招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商银行股份有限公司合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币68,632.04万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于2024年8月29日出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2024〕10233号）。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2024-082）。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-081）。

本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：

单位：人民币万元

| 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 购买日 | 到期日 | 本年收益 | 是否赎回 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司扬州分行营业部 | 广发银行“薪加薪16号”W款2024年第247期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌机构版) | 3,000.00 | 2024/9/13 | 2024/10/18 | 6.90 | 是 | |
| 广发银行股份有限公司扬州分行营业部 | 广发银行“薪加薪16号”W款2024年第257期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看涨)(机构版) | 800.00 | 2024/9/30 | 2024/11/14 | 1.04 | 是 | |
| 广发银行股份有限公司扬州分行营业部 | 广发银行“物华添宝”W款2024年第219期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) | 2,900.00 | 2024/11/5 | 2024/12/10 | 6.12 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司合肥瑞海支行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01618期 | 5,000.00 | 2024/10/1 | 2024/11/1 | 9.77 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司合肥瑞海支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06695期 | 5,000.00 | 2024/11/9 | 2024/12/9 | 8.84 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司合肥瑞海支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07330期 | 5,000.00 | 2024/12/12 | 2025/1/11 | | 否 | 5,000.00 |
| 合计 | | 21,700.00 | | | 32.66 | | 5,000.00 |

注：合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

由于本次公开发行实际募集资金净额114,252.79万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的募集资金金额114,870.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附件1。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇成公司，公司拟使用募集资金30,000.00万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成提供20,000.00万元人民币借款。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-077）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20,000.00万元。

（十）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（十一）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，汇成股份管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了汇成股份募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，汇成股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，汇成股份募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对汇成股份2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件1：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司　金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | | 114,252.79 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 105,958.26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 105,958.26 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | | | |
| 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 28,886.64 | 28,886.64 | -6,113.36 | 82.53 | 2026年6月 | 752.06 | 不适用 | 否 | | | | |
| 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 47,814.81 | 47,814.81 | -2,185.19 | 95.63 | 2026年6月 | 718.31 | 不适用 | 否 | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 29,870.00 | 29,252.79 | 29,252.79 | 29,256.81 | 29,256.81 | 4.02 | 100.01 | | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | |
| 合计 | — | 114,870.00 | 114,252.79 | 114,252.79 | 105,958.26 | 105,958.26 | -8,294.53 | — | — | 1,470.38 | — | — | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见本专项报告三（二）之说明 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | | | | 详见本专项报告三（四）之说明 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 详见本专项报告三（九）之说明 | | | | | | | | | | | | |

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”是以本公司及江苏汇成为实施主体，是本公司及江苏汇成利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，本公司及江苏汇成12吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。

注4：上表中合计值尾差系四舍五入导致。

公司代码：688403　公司简称：汇成股份
转债代码：118049　转债简称：汇成转债

# 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本837,981,982股，扣减回购专用证券账户中股份总数11,910,000股后可参与利润分配的股份数为826,071,982股。以此为基数计算，合计拟派发现金红利78,476,838.29元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.12%。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分派预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 汇成股份 | 688403 | 不适用 |

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 奚鹏 | 王赞 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号 | 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号 |
| 电话 | 0551-67139968-7099 | 0551-67139968-7099 |
| 传真 | 0551-67139968-7099 | 0551-67139968-7099 |
| 电子信箱 | zhengquan@unionsemicon.com.cn | zhengquan@unionsemicon.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营集成电路高端先进封装测试服务，所封测的芯片类型目前聚焦在液晶面板核心部件之一显示驱动芯片。公司直接客户主要为显示驱动芯片设计企业，客户自购晶圆委托公司为其提供凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）加工服务，加工完成后的显示驱动芯片由客户销售给下游，主要应用于LCD、OLED显示面板及模组，并应用于智能手机、高清电视等各类终端产品。

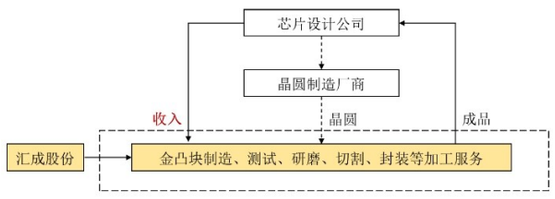
报告期内，公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务。在封测业务制程方面，公司主营业务收入一般按照凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）四大制程进行划分；按照所封测芯片的细分类型，主要分为LCD面板显示驱动芯片（DDI）、触控与显示驱动集成芯片（TDDI）、AMOLED面板显示驱动芯片等；按照终端应用场景，主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、汽车电子、智能穿戴、电子标签等类别。

2.2 主要经营模式

（1）盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业，采用行业惯用的OSAT（半导体封装测试外包）模式，在OSAT模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节，专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。

公司根据客户需求，通过工艺设计，利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行金凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司系根据所提供服务收取加工服务费的方式以获取收入和利润。具体图示如下：




（2）采购模式

公司的采购模式为按需采购，由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单，根据需求单向供应商下达采购订单并签约。

对于主要采购材料，公司一般会与供应商约定年度协议价格，未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款，由物料采购部根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后，到期支付款项。

采购材料到货后由品质保障部进行验收，品质保障部核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在系统中制作验收单，经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制，以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购，评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等，并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面，对质量问题实时反馈并要求修正。

（3）生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制，以销定产”受托加工生产模式，即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料，公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料，接着根据客户需求完成相应工艺制程，而后将成品交付予客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务，拥有专业的工程技术和生产管理团队，并配备了专业的高精度自动化生产设备，可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

（4）销售模式

公司采用直销模式进行销售，并制定了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业，公司需要对客户的技术需求进行工艺验证，验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务，并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

基于定制化的受托加工模式，公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点，整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下，与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

金凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定，含金原料是金凸块制造环节的主要材料成本，定价结合黄金的市场价格及不同规格芯片所需耗用的黄金用量确定。

晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求，综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下，与客户协商确定。

（5）研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒，并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势，进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段，具体情况如下：

①项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道：一是研发中心会定期调研行业发展趋势，结合公司发展战略及现有技术基础，选择相应的新工艺、新产品的研发立项；二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息，形成对市场需求的综合判断，针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

②项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后，将先进行初步论证，如初步论证可行，则会同公司管理层共同讨论立项建议，根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判，确定具体研发内容，进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署，形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

③工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求，开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组，积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后，将召开评审会议，对项目取得相应的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果，对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善，并及时反馈给研发中心相关负责人。

④样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制，专项课题小组辅以监督和技术指导，试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的，则样品还需经过客户验证。

⑤研发结项

在验证合格后，研发中心将召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过后专项课题小组提交研发结项报告，项目研发工作结束。

2.3 所处行业情况

（1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

①所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试，根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。

②行业发展阶段及基本特点

自上世纪50年代集成电路诞生以来，集成电路封装测试行业随着集成电路设计和制造技术的发展而演进，已历经了60余年的发展过程，大致可以划分为五个发展阶段：20世纪70年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段，以通孔插装型封装为主；20世纪80年代以后开始进入第二阶段，以表面贴装型封装为主；20世纪90年代以后，以芯片级封装（CSP）、晶圆级封装（WLP）、球栅阵列封装（BGA）为代表的面积阵列型封装技术逐渐成熟，进入封装技术发展的第三阶段；20世纪末开始，凸块制造（Bumping）、系统级封装（SiP）等技术推动集成电路封装进入第四阶段；进入21世纪之后，倒装封装（FC）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、系统级单芯片封装（SoC）、扇出型封装（Fan-out）等形式的集成电路封装层出不穷，封装技术发展进入第五阶段。基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》，并结合行业内按照封装工艺分类的惯例，封装分为传统封装（第一阶段和第二阶段）及先进封装（第三至第五阶段）。

目前，全球封装行业的主流技术正在向以倒装封装（FC）、凸块制造（Bumping）、系统级封装（SiP）、系统级单芯片封装（SoC）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）为代表的先进封装技术迈进。随着智能手机、智能穿戴等电子产品持续向小型化、多功能化方向发展，对芯片在集成化、小尺寸、低功耗等方面的要求也越来越高。在后摩尔定律时代，以FC、2.5D/3D封装、Fan-out、SiP等为代表的先进封装正逐步发展为推动芯片效能提升的主流发展方向，先进封装在整体封装产业当中的占比正稳步提升。

③主要技术门槛

集成电路高端先进封装测试属于高新技术产业，先进封装测试服务的专业性、复杂性、系统性特征，决定了企业进入该行业需突破较高的技术壁垒。显示驱动芯片封装测试对设备、工艺以及生产稳定性有着严苛的要求，客户验证和导入的周期较长，目前国内仅有少量企业具备显示驱动芯片封装测试全流程核心工艺技术并批量稳定供应头部客户。

显示驱动芯片封装测试的技术壁垒主要体现在凸块制造环节工艺复杂性、全流程良率稳定性两个方面。

凸块制造环节具有溅镀、黄光（光刻）、蚀刻、电镀等多道环节，需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的凸块作为芯片封装的引脚，对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均具有较高的要求，并且显示驱动芯片成本经济性也对金凸块制程当中的黄金用量控制技术提出了很高的要求，因而目前中国大陆具备较高良率水平及稳定量产凸块制造能力的封测企业相对较少。

显示驱动芯片领域对于封装测试有着较高的良率要求。显示驱动芯片应用于各类电子产品液晶面板，单块液晶面板的价值较高，特别是应用于高清电视等终端的大尺寸面板。如果在封装测试环节不合格品流向终端客户，封测企业将面临较大金额的质量赔付，并且还存在声誉损失甚至客户流失。正是因为客户以及终端对良率的高要求，倒逼显示驱动芯片封测企业需要投入大量技术资源和管理资源用于提高良率，保证生产稳定性，行业新进入者面临着较高的良率稳定性壁垒。

（2）公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入12吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。近年来，随着公司IPO募投项目全面结项及可转债募投项目快速实施，公司在产能规模、实际产出、市场份额等方面均实现了跨越式发展，技术水平、产品良率及客户认可度亦稳步提升，在全球显示驱动芯片封测领域已跻身第一梯队，具备领先优势。

（3）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

AMOLED显示技术及车载大屏显示渗透率提升有望成为显示驱动芯片增量市场。AMOLED即有源矩阵有机发光二极管，属于第三代显示技术，AMOLED显示屏具有能耗低、发光率好、亮度高和轻薄等优点。随着需求驱动和技术进步，消费者更加青睐于显示屏幕画质优良、更轻更薄、健康护眼、节能省电的各类电子产品，在智能手机、高清电视等消费电子产品当中AMOLED显示屏渗透率逐步提升。显示驱动芯片作为AMOLED屏幕的上游产业，近年来AMOLED显示驱动芯片出货量正在快速增长。根据Frost & Sullivan的数据，2020年全球AMOLED显示驱动芯片出货量大约14.0亿颗，预计2025年全球AMOLED显示驱动芯片出货量将达到24.5亿颗。Omdia预计2024年AMOLED显示驱动芯片的需求量将同比增长19%，并且在2028年前都将保持较高的复合增长率，其中智能手机在AMOLED显示驱动芯片各应用领域当中占据最大份额。随着京东方、维信诺、天马、和辉光电等境内面板厂商AMOLED新建产线逐步落地，以及晶圆代工厂AMOLED高阶制程代工产能释放，AMOLED显示屏及驱动芯片将进一步提升市场渗透率，成为封测企业持续获益的增量市场。

在智能化、数字化、网联化的时代，智能网联汽车不仅仅是一种交通工具，更是一个移动的智能终端，化身为办公室和家庭之外的“第三空间”。智能座舱对车载显示提出新需求，各类车载显示创新应用不断实现迭代和创新。在智能驾驶、智慧座舱升级换代的背景下，车载显示屏幕尺寸和数量显著上升。据Omdia《车载显示情报服务》的最新报告，2024年全球汽车显示屏面板出货量达到2.32亿片，同比增长6.3%，这一增长主要得益于先进座舱显示屏需求的不断增长，特别是在中国，抬头显示面板（HUD）、乘客显示器和室内后视镜等产品势头强劲。消费者对车载显示的要求越来越趋近智能手机，随着车载显示大屏化、多屏化、功能集成化的渗透和演进，以及智能网联汽车的不断普及，车载显示有望成为显示驱动芯片领域新蓝海。

此外，公司高度重视包括硅基OLED在内的其他新型显示技术应用前沿开发和布局，已与国内面板领先企业建立深度合作关系，助力AR/VR等新兴应用终端加速落地。

2、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,591,223,702.62 | 3,596,296,963.42 | 27.67 | 3,195,632,455.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,201,070,920.63 | 3,132,030,678.41 | 2.20 | 2,903,705,902.53 |
| 营业收入 | 1,501,019,718.15 | 1,238,293,041.85 | 21.22 | 939,652,817.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 159,764,193.29 | 195,985,017.79 | -18.48 | 177,224,972.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 134,003,912.85 | 168,194,709.94 | -20.33 | 126,181,697.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,863,803.23 | 351,459,642.36 | 42.51 | 601,141,680.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.12 | 6.49 | 减少1.37个百分点 | 9.19 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.24 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.96 | 6.37 | 减少0.41个百分点 | 6.93 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 315,302,067.12 | 358,349,695.44 | 396,420,593.90 | 430,947,361.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,327,629.49 | 33,348,438.78 | 41,164,715.43 | 58,923,409.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,307,774.13 | 28,311,420.31 | 35,133,464.00 | 48,251,254.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,101,149.97 | 88,664,792.84 | 88,633,677.64 | 208,464,182.78 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

3、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 20,831 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 21,890 | | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | | | | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 | | | | | |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 | |
| 扬州新瑞连 | 0 | 174,103,622 | 20.78 | 174,103,622 | 无 / 0 | 其他 |
| 汇成投资 | 0 | 37,716,667 | 4.50 | 37,716,667 | 无 / 0 | 境外法人 |
| 上海添橙投资管理有限公司－添橙添利十二号私募证券投资基金 | 29,614,058 | 29,614,058 | 3.53 | 0 | 无 / 0 | 其他 |
| 杨会 | 0 | 23,593,934 | 2.82 | 23,593,934 | 无 / 0 | 境内自然人 |
| ADVANCE ALLIED LIMITED | 0 | 20,000,000 | 2.39 | 0 | 无 / 0 | 境外法人 |
| 杨绍校 | 11,584,935 | 18,251,602 | 2.18 | 0 | 无 / 0 | 境外自然人 |
| 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 0 | 18,181,818 | 2.17 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 18,050,000 | 18,050,000 | 2.15 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| 安徽正奇资产管理有限公司 | 400,000 | 16,100,000 | 1.92 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有